

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏艾森半导体材料股份有限公司
2025 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：艾森股份
保荐代表人姓名：刘伟	联系电话：021-38966588
保荐代表人姓名：张帅	联系电话：021-38966588

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，对艾森股份进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、市场竞争风险

随着下游封测厂商持续加大投入先进封装技术，先进封装用电子化学品面临着良好的发展机遇。公司推出了多款先进封装用光刻胶及配套试剂产品。先进封装领域具有较好的市场前景，其他内资厂商持续增加研发投入、扩建产能或推出新产品参与市场竞争。如公司未能持续更新技术及开发产品，降低产品成本，则公司将面临不断加大竞争压力，并降低公司光刻胶配套试剂的收入增速或市场份

额。下游封测厂商对光刻胶的可靠性和稳定性要求极高，更换供应商难度较大。公司与国际巨头争夺高端市场，面临无法抢占其市场份额的竞争风险。

综上，如果公司不能根据市场需求持续更新技术和开发产品，保持产品和技术竞争力，可能无法与国内外企业进行有效竞争，从而对公司的市场份额、市场地位、经营业绩造成不利影响。

2、自研光刻胶产品产业化风险

公司自研光刻胶产品主要包括先进封装用负性光刻胶、OLED阵列制造正性光刻胶和晶圆制造i线正性光刻胶。公司主要自研光刻胶产品虽均已通过行业主要客户的认证并进入正式供货阶段，但尚未能实现对下游客户在用产品的完全替代，处于产业化前期，对收入贡献较低。由于下游客户对光刻胶的产品性能、品质及稳定性要求严格，相关产品认证时间及量产周期均较长，且影响因素众多，如受产品稳定性不足、客户推迟上线安排、下游市场需求变动等因素影响，公司自研光刻胶产品无法实现大规模产业化，将对公司未来发展带来不利影响。

（二）经营风险

1、毛利率下降的风险

公司产品包括电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂以及电镀配套材料三大类别，不同类别产品的毛利率水平主要受所处行业情况、市场供求关系、产品技术特点、产品更新迭代、公司销售及市场策略、原材料价格等因素综合影响而有所差异。若原材料价格出现回升，或公司未能根据市场变化及时进行产品技术升级，产品技术缺乏先进性，公司市场推广未达预期，造成高毛利产品销售占比下降，可能导致公司毛利率水平下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。

2、原材料价格波动的风险

公司原材料主要包括各种溶剂类和固体类的化工原料，以及以锡材（锭）为主的金属材料；上述材料作为大宗工业原材料，其价格易受国际原油价格或国际金属价格的波动影响。

（三）行业风险

1、半导体行业周期变化风险

目前公司产品主要应用于集成电路、半导体显示等半导体产业。近年来，受益于下游消费电子、计算机、通信、汽车、物联网等终端应用领域需求的持续增长，全球半导体特别是集成电路产业实现了快速发展。中国集成电路产业在下游市场的推动以及政府与资本市场的刺激下，获得了强大的发展动力。由于全球半导体行业景气周期与宏观经济、下游终端应用需求以及自身产能库存等因素密切相关，如果未来半导体行业市场需求因宏观经济或行业环境等原因出现下滑，将对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。如半导体行业下行周期持续，或公司不能通过开发新产品、开拓新客户等方式进行有效应对，将可能对公司经营业绩造成不利影响。

2、细分行业市场规模较小的风险

公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。电子化学品具有品类多，应用领域细分等特点。公司主要产品为电镀液及配套试剂，主要应用于传统封装领域。公司的市场占有率较高，增长空间有限，存在细分行业市场规模较小的风险。虽然公司立足于传统封装领域电镀液及配套试剂，沿着产业链向其他应用领域发展，已逐步覆盖被动元件、PCB、先进封装、晶圆制造、光伏等领域的电镀工艺环节，若未来上述细分行业市场容量增长不及预期，将对公司经营情况和业绩情况产生不利影响。

三、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年上半年，公司主要财务数据及指标如下表所示：

单位：万元

主要财务数据	2025年 1-6月	2024年 1-6月	增减幅度
--------	------------	------------	------

营业收入	27,989.29	18,579.73	50.64%
归属于上市公司股东的净利润	1,678.20	1,373.95	22.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,443.67	819.63	76.14%
经营活动产生的现金流量净额	2,285.09	-3,406.82	不适用
主要财务数据	2025年6月30日	2024年12月31日	增减幅度
归属于上市公司股东的净资产	99,220.61	97,397.15	1.87%
总资产	133,236.21	124,410.57	7.09%
主要财务指标	2025年1-6月	2024年1-6月	增减幅度
基本每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.09	77.78%
加权平均净资产收益率（%）	1.71	1.33	增加0.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.47	0.79	增加0.68个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	10.87	11.33	减少0.46个百分点

1、报告期内，公司实现营业收入27,989.29万元，同比增长50.64%。其中，电镀液及配套试剂同比增长64.32%，光刻胶及配套试剂同比增长53.49%。公司持续加大先进封装和晶圆领域的研发投入及市场开拓力度，营业收入呈现出持续增长的趋势。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为1,678.20万元，同比增长22.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,443.67万元，同比增长76.14%。报告期内，公司扣非归母净利润大幅增长，主要原因系：（1）报告期内，公司营业收入保持较快增长；（2）报告期内，公司优化产品结构，毛利率有所提高；（3）报告期内，公司提高内部管理效率，期间费用的增长幅度低于营业收入的增长幅度。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额2,285.09万元，经营活动产生的现金流量较去年同期显著改善，主要原因系报告期内，公司提高资金管理效率，增加票据付款，销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度大于本期购买商品、

接受劳务支付的现金增长幅度。

五、核心竞争力的变化情况

公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。作为国内半导体材料领域的领军企业，公司始终专注于关键电子化学品的自主研发与产业化应用。经过多年努力，公司已构建起覆盖半导体全产业链的材料解决方案，逐步取代国外材料公司成为半导体封装电镀化学品领域的国内主力供应商，逐步向晶圆制造、显示面板及IC载板等领域延伸，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大业务板块。公司是国内少数能同时覆盖半导体封装、晶圆制造和半导体显示的全链条电子材料公司。

在电镀液及配套试剂领域，公司已完成从跟随者到引领者的角色转变。通过持续的技术创新，产品性能指标已达到国际一流水准，部分关键参数实现行业领先，成功打破国外厂商长期垄断的市场格局。目前，公司电镀液产品已构建起丰富且极具竞争力的产品矩阵，在传统封装和先进封装领域均实现了全品类覆盖，并成功实现晶圆28nm、5nm先进制程等高端应用领域的市场突破。

在光刻胶及配套试剂方面，公司构建了从特色光刻胶、光刻胶核心原材料到配套试剂的完整研发体系，产品覆盖半导体全产业链应用场景，多项技术填补国内空白。公司以先进封装负性光刻胶、晶圆制造PSPI以及OLED阵列制造用光刻胶等特色工艺光刻胶为突破口，覆盖晶圆制造、先进封装及显示面板等应用领域，成功打破国外垄断，并逐步向先进制程延伸，如ICA化学放大光刻胶、KrF光刻胶。

先进封装应用方面，公司先进封装用g/i线正性光刻胶和Bumping负性光刻胶已覆盖多家主流封装客户，市场份额持续提升。在未来的2-3年，公司将进一步丰富产品型号，以实现全品类覆盖，不断巩固和扩大在该领域的市场份额，目标成为国内先进封装光刻胶和PSPI的主力供应商。目前公司负性光刻胶已成功拓展应用到玻璃基封装，获得头部客户量产订单。介电层/缓冲防护层应用负性PSPI和低温固化负性PSPI在客户端验证进展顺利。

晶圆制造应用方面，公司正性PSPI光刻胶目前小量产中，同步在多家晶圆客户验证；超高感度PSPI（化学放大型）在主流晶圆客户可靠性验证阶段；晶圆ICA化学放大光刻胶在客户端验证测试顺利，部分指标优于国际厂商对标产品；公司已组建专家团队布局KrF光刻胶产品，公司高厚膜高深宽比KrF光刻胶目前处于实验室研发阶段，力求填补国内空白。

综上，2025年上半年公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

公司主要产品与下游行业结合紧密，需要企业具备丰富的实践经验和技术积累，研发技术门槛较高，具有研发投入大、研发周期长，下游客户认证时间长的特点。自成立以来，公司始终坚持以客户需求为导向，持续保持高研发投入，以保持技术领先和持续创新。

2025年1-6月，公司研发费用3,041.99万元，同比增长44.50%，研发投入占营业收入比重为10.87%。2025年上半年，公司各项在研项目均有序推进，部分项目取得阶段性成果。2025年上半年，公司新增申请发明专利10项，新取得发明专利11项，研发成果持续得到体现。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2062号）同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266号”批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为28.03元/股。本次发行募集资金总额为人民币61,759.44万元，扣除各项发行费用（不

含增值税)后,本次募集资金净额为 54,449.71 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2023 年 12 月 1 日出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第 ZA15561 号)。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	61,759.44
减:保荐及承销费用	4,627.89
募集资金实际到账金额	57,131.54
减:募集资金项目投入	15,532.18
支付发行费用	2,070.60
以闲置募集资金购买理财产品	46,800.00
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	24,975.72
募集资金专项账户手续费支出	0.15
注销募集账户利息余额转出	0.01
加:闲置募集资金购买理财产品赎回	42,800.00
募集资金理财产品利息收益	521.40
募集资金专项账户存款利息收入	193.84
募集资金专项账户余额	11,268.13

公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、

冻结及减持情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务/身份	直接持股数（万股）	间接持股数（万股）	合计持股数（万股）	合计持股比例	2025 年上半年的质押、冻结及减持情况
1	张兵	董事长/实际控制人	1,903.1621	222.4387	2,125.6008	24.12%	无
2	蔡卡敦	实际控制人	684.7826	-	684.7826	7.77%	无
3	向文胜	董事、总经理	-	128.7747	128.7747	1.46%	无
4	陈小华	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	53.3597	56.9170	110.2767	1.25%	无
5	杨一伍	董事	88.9328	58.6957	147.6285	1.68%	无
6	孙清清	独立董事	-	-	-	-	-
7	黄晓刚	独立董事	-	-	-	-	-
8	李挺	独立董事	-	-	-	-	-
9	程瑛	监事会主席	-	-	-	-	-
10	沈鑫	监事	-	-	-	-	-
11	熊秋丽	职工代表监事	-	-	-	-	-
12	赵建龙	副总经理	62.2530	17.7866	80.0396	0.91%	无
13	谢立洋	副总经理	-	46.2451	46.2451	0.52%	无
14	吕敏	财务总监	-	-	-	-	-

2025 年上半年，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

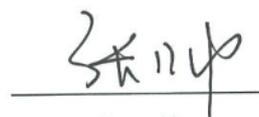
截至2025年6月30日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人:


刘 伟


张 帅

